

SEMICON Japan 2025

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では“SEMICON Japan 2025”に出展する運びとなりました。

ご多忙とは存じますが、是非ご来場賜り、弊社ブースにお立ち寄りいただきたくご案内申し上げます。

開催概要

会 期 | 2025年12月17日(水)～19日(金)
10:00～17:00

会 場 | 東京ビッグサイト 東5ホール

ブース | 小間番号 E5832



来場事前登録は
こちらから



展示内容

展示の見どころ

私たちは、プリント基板の設計・製造技術を軸に、EMSから各種メカトロニクス開発まで柔軟に対応する、エレクトロニクス分野のトータルソリューションカンパニーです。半導体産業に向けて、半導体パッケージ基板生産体制を日本、ベトナムとグローバルに展開しております。製品展示では、半導体を内蔵した部品内蔵基板や、パワー半導体に対応した高絶縁高放熱を特長としたメタルベース基板、またパッケージ基板に対応した実装治具をご紹介します。ぜひ当社ブースまで足をお運び頂き、当社の最新技術をご覧ください。

出展製品・技術

- 半導体パッケージ基板 = FCBGAやCSPに対応したABF基板およびNANDやメモリモジュールに対応したmSAP技術のご紹介
- 部品内蔵基板 = 部品を基板内部に埋め込むことで、小型化・薄型化を実現
- 絶縁放熱基板 = 高放熱銅ベース基板から回路もアルミで構成したALLアルミ基板等、幅広いラインナップ
- 実装治具 = 大型ワークサイズ対応 ボール搭載用のメタルマスクのご紹介

メイコーの電子回路基板技術は高機能、高信頼性でエレクトロニクス産業の発展に貢献します。

SEMICON Japan 2025 WEB Boothについて

展示会にご来場いただけない皆様、もっとじっくり製品紹介を見たい皆様、製品やサービスをご紹介するWeb展示会特設サイト「SEMICON Japan 2025」へこの機会にぜひお越しください。

